

## RX ファミリ

### RX Driver Package Ver.1.31

#### 要旨

本書は、RX ファミリ用 RX Driver Package Ver. 1.31 のアプリケーションノートです。

本アプリケーションノートでは、RX Driver Package の構成、特徴、使用方法と RX Driver Package を利用したサンプルアプリケーションプログラムについて説明します。

なお、旧 Ver.の RX Driver Package は以下の URL から入手できます。

RX Driver Package ページ : <https://www.renesas.com/rdp>

#### 動作対象デバイス

RX110 グループ、RX111 グループ、RX113 グループ、RX130 グループ、RX13T グループ  
RX230 グループ、RX231 グループ、RX23E-A グループ、RX23T グループ、RX23W グループ  
RX24T グループ、RX24U グループ

RX64M グループ、RX65N グループ、RX651 グループ、RX66N グループ、RX66T グループ、  
RX671 グループ

RX71M グループ、RX72T グループ、RX72M グループ、RX72N グループ

なお、評価ボードは Renesas Starter Kit を使用しています。

お客様の製品にてご利用される際は、お客様の環境に合わせて十分に評価してください。

また、本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

#### 動作確認に使用した統合開発環境

ルネサス エレクトロニクス製 e<sup>2</sup> studio 2021-01 または IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.01 を使用しています。

#### 対象コンパイラ

Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family

GCC for Renesas RX

IAR C/C++ Compiler for Renesas RX

各コンパイラの動作確認内容については「1.2 動作確認環境」を参照してください。

## 関連ドキュメント

RX ファミリ ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685)

RX Driver Package Application に付属するユーザーズマニュアル

## 目次

1. 概要 .....	4
1.1 適用 .....	4
1.2 動作確認環境 .....	5
2. RX Driver Package とは .....	6
3. FIT モジュール一覧 .....	7
3.1 ボード・サポート・パッケージ (BSP) .....	7
3.2 デバイスドライバ .....	7
3.3 ミドルウェアモジュール/インタフェースモジュール .....	9
4. 使用方法 .....	10
5. 補足 .....	11
5.1 サンプルプログラムについて .....	11
5.2 各 FIT モジュールの API 情報の格納場所について .....	11
5.3 ダウンロードした RX Driver Package の確認方法 .....	11
改訂記録 .....	12

## 1. 概要

### 1.1 適用

本アプリケーションノートは、RX ファミリ用 RX Driver Package Ver1.31 に適用します。構築を以下に示します。

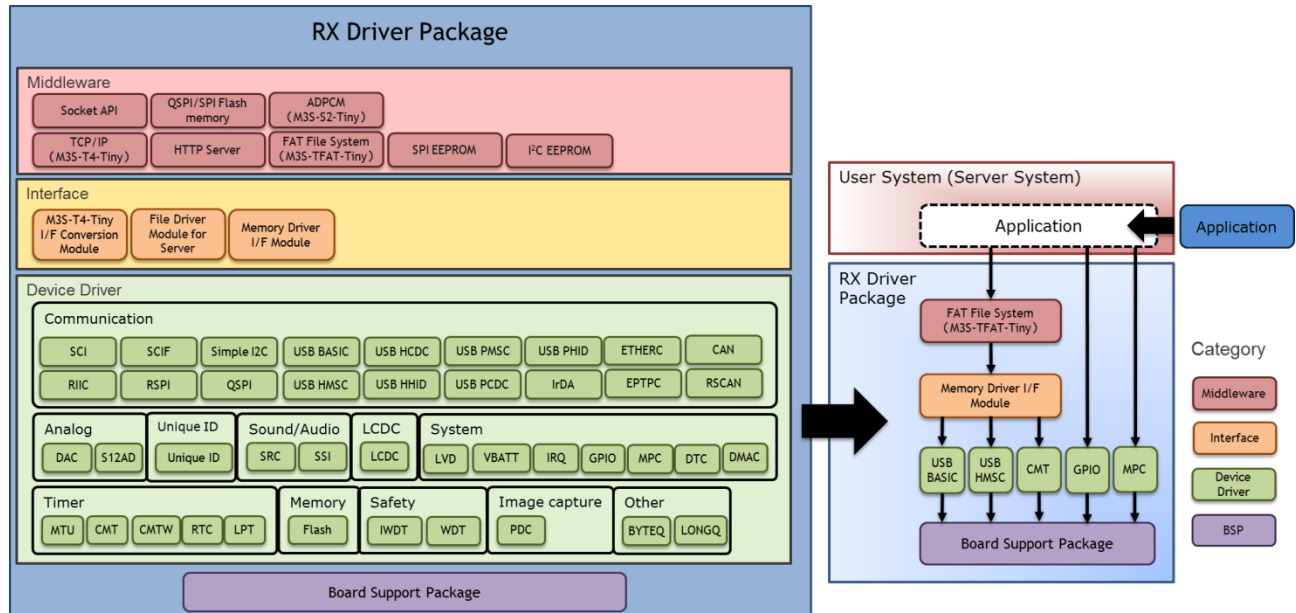


図 1-1 構築イメージ

## 1.2 動作確認環境

本パッケージの動作確認環境を以下に示します。

表 1-1 動作確認環境

項目	内容
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2021-01 IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.01
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 C/C++ compiler for RX family V. 3.03.00 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -lang = c99
	GCC for Renesas RX 8.3.0.202102 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -std=gnu99
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.01 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定
エンディアン	ビッグエンディアン／リトルエンディアン
RDP のバージョン	Ver. 1.31

## 2. RX Driver Package とは

RX Driver Package は、マイコンの初期化、フラッシュセルフプログラミング、タイマ制御、UART 通信、A/D 等の基本機能や、USB、Ethernet 等の応用機能を利用するためのソフトウェアパッケージです。

- FIT ミドルウェアモジュール
- FIT インタフェースモジュール
- FIT 周辺機能用デバイスドライバモジュール
- ボード・サポート・パッケージ(BSP)モジュール

また、RX Driver Package を活用したサンプルアプリケーションプログラム(RX Driver Package Application)を用いることで、ユーザアプリケーション層の開発が容易になります。

### 3. FIT モジュール一覧

本パッケージに入っている FIT モジュール一覧を以下に示します。

RX ファミリ RX Driver Package Ver. 1.30 (R01AN5882) リリース後、FIT モジュールを更新しました。  
RX ファミリ RX Driver Package Ver. 1.30 との差分情報を表 3-1、表 3-2、表 3-3 に示します。

「差分情報」欄に示す用語の意味を以下に示します。

「同一」	同一のものを同梱します
「更新」	更新されたものを同梱します。 更新内容はそれぞれのドライバによって異なりますので、各ドライバのドキュメントの確認をお願いします。
「追加」	今回追加されたもの

「GCC/IAR 対応状況」欄に示す用語の意味を以下に示します。

「対応」	対応します
「制限付き」	制限付きで対応します 詳細は、各 FIT モジュールのドキュメントを確認してください。
「未対応」	未対応。今後のバージョンで順次対応予定です。

#### 3.1 ボード・サポート・パッケージ (BSP)

表 3-1 ボード・サポート・パッケージ (BSP) 差分情報

モジュール名	FIT モジュール名	Rev.	差分情報	GCC/IAR 対応状況
ボード・サポート・パッケージ (BSP)	r_bsp	6.11	更新	対応

#### 3.2 デバイスドライバ

表 3-2 デバイスドライバ 差分情報一覧

モジュール名	FIT モジュール名	Rev.	差分情報	GCC/IAR 対応状況
電圧検出回路(LVD)	r_lvd_rx	3.70	更新	対応
消費電力低減機能(LPC)	r_lpc_rx	2.02	更新	対応
バッテリーバックアップ機能(VBATT)	r_vbatt_rx	2.00	更新	対応
割り込みコントローラ(IRQ)	r_irq_rx	3.70	更新	対応
データトランスファコントローラ(DTC)	r_dtc_rx	3.70	更新	対応
DMA コントローラ(DMAC)	r_dmaca_rx	2.60	更新	対応
I/O ポート(GPIO)	r_gpio_rx	4.00	更新	対応
マルチファンクションピンコントローラ(MPC)	r_mpc_rx	3.90	更新	対応
コンペアマッチタイマ(CMT)	r_cmt_rx	4.80	更新	対応
コンペアマッチタイマ W(CMTW)	r_cmtw_rx	2.40	更新	対応
リアルタイムクロック(RTC)	r_rtc_rx	2.81	更新	対応
ローパワータイマ(LPT)	r_lpt_rx	2.01	同一	対応
独立ウォッチドックタイマ(IWDT)	r_iwdt_rx	3.70	更新	対応
ウォッチドックタイマ(WDT)	r_wdt_rx	2.50	更新	対応
シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI: 調歩同期式/クロック同期式)	r_sci_rx	3.80	更新	対応
FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIFA: 調歩同期式/クロック同期式)	r_scif_rx	2.01	同一	対応
シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI: 簡易 I <sup>2</sup> C バス)	r_sci_iic_rx	2.48	更新	対応
I <sup>2</sup> C バスインタフェース(RIIC)	r_riic_rx	2.48	更新	対応

シリアルペリフェラルインタフェース	r_rspi_rx	3.01	更新	対応
クワッドシリアルペリフェラルインタフェース (QSPI : シリアルメモリ制御用デバイスドライバ)	r_qspi_smstr_rx	1.14	同一	対応
USB Basic Firmware	r_usb_basic	1.31	更新	対応
USB Host Mass Storage Class	r_usb_hmsc	1.31	更新	対応
USB Host Communication Device Class	r_usb_hcdc	1.31	更新	対応
USB Host Human Interface Device Class	r_usb_hhid	1.31	更新	対応
USB Peripheral Mass Storage Class	r_usb_pmsc	1.31	更新	対応
USB Peripheral Communications Device Class	r_usb_pcdc	1.31	更新	対応
USB Peripheral Human Interface Device Class	r_usb_phid	1.31	更新	対応
USB Basic Firmware mini	r_usb_basic_mini	1.20	同一	対応
USB Host Mass Storage Class mini	r_usb_hmsc_mini	1.20	同一	対応
USB Host Communication Device Class mini	r_usb_hcdc_mini	1.20	同一	対応
USB Host Human Interface Device Class mini	r_usb_hhid_mini	1.20	同一	対応
USB Peripheral Mass Storage Class mini	r_usb_pmsc_mini	1.20	同一	対応
USB Peripheral Communications Device Class mini	r_usb_pcdc_mini	1.20	同一	対応
USB Peripheral Human Interface Device Class mini	r_usb_phid_mini	1.20	同一	対応
イーサネットコントローラ用 PTP コントローラ (EPTPC)	r_ptp_rx	1.17	同一	対応
EPTPC Light モジュール	r_ptp_light_rx	1.14	同一	対応
イーサネットコントローラ(ETHERC)	r_ether_rx	1.21	同一	対応
CAN Module (CAN)	r_can_rx	5.10	更新	対応
CAN モジュール(RSCAN)	r_rscan_rx	2.31	同一	対応
IrDA インタフェース(IrDA)	r_irda_sci_rx	1.01	同一	未対応
パラレルデータキャプチャユニット(PDC)	r_pdc_rx	2.05	同一	対応
SD ホストインタフェース(SDHI)	r_sdhi_rx	2.07	更新	対応
SD スレーブインタフェース(SDSI)	r_sdsi_rx	2.02	同一	対応
マルチメディアカードインタフェース (MMCIF)	r_mmcif_rx	1.07	同一	対応
12 ビット A/D コンバータ(S12AD)	r_s12ad_rx	4.80	更新	対応
D/A コンバータ(DAC)	r_dac_rx	4.50	同一	対応
BLE モジュール(BLE)	r_ble_rx23w	2.20	更新	制限付き
QE Utility モジュール(Profile)	r_ble_qe_utility	1.00	同一	未対応
メッシュモジュール(Mesh)	r_mesh_rx23w	1.10	同一	未対応
$\Delta$ - $\Sigma$ モジュレータインタフェース(DSMIF)	r_dsmif_rx	1.00	同一	制限付き
フラッシュメモリ(内蔵フラッシュ書き換え)	r_flash_rx	4.70	更新	対応
サンプリングレートコンバータ(SRC)	r_src_api_rx	1.14	同一	対応
シリアルサウンドインタフェース(SSI)	r_ssi_api_rx	2.03	更新	対応
TSIP(Trusted Secure IP)モジュール	r_tsip_rx	1.12	更新	対応
LCD コントローラ/ドライバ(LCDC)	r_lcdc_rx	1.02	同一	対応
グラフィック LCD コントローラ(GLCDC)	r_glcde_rx	1.50	同一	対応
ユニーク ID リード	r_uid_rx	1.14	同一	対応
Byte Queue Buffer(データ管理)	r_byteq	1.90	更新	対応
Long Queue Buffer(データ管理)	r_longq	1.82	同一	対応
イベントリンクコントローラ(ELC)	r_elc_rx	2.00	同一	対応
RX DRW2D ドライバ(DRW2D)	r_drw2d_rx	1.11	更新	対応
emWin v.6.14 モジュール(EMWIN)	r_emwin_rx	1.30	同一	未対応
QE CTSU Module(CTSU)	r_cts_u_qe	2.00	更新	対応
Aeropoint モジュール	r_aeropoint_rx	1.00	同一	未対応
シリアルペリフェラルインタフェース (RSPIA)	r_rspia_rx	1.00	追加	対応
シリアルコミュニケーションインタフェース (RSCI)	r_rsci_rx	1.00	追加	対応
シリアルペリフェラルインタフェース (QSPIX)	r_qspix_rx	1.00	追加	対応
ハイスピード I2C バスインタフェース (RIICHS)	r_riichs_rx	1.00	追加	対応



## 3.3 ミドルウェアモジュール/インタフェースモジュール

表 3-3 ミドルウェアモジュール/インタフェースモジュール 差分情報一覧

モジュール名	FIT モジュール名	Rev.	差分情報	GCC/IAR 対応状況
組み込み用 M3S-T4-Tiny モジュール	r_t4_rx	2.10	同一	対応
Ethernet ドライバと組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny のインタフェース変換モジュール	r_t4_driver_rx	1.09	同一	対応
システムタイマモジュール	r_sys_time_rx	1.01	同一	対応
SD モード SD メモリカードドライバ	r_sdc_sdmem_rx	3.00	同一	対応
フラッシュメモリデータ管理モジュール (DATFRX)	r_datfrx_rx	2.01	同一	未対応
EEPROM アクセス クロック同期制御モジュール	r_eeprom_spi	3.02	同一	対応
Serial Flash memory アクセス クロック同期制御 モジュール	r_flash_spi	3.02	同一	対応
メモリアクセス用ドライバインタフェース	r_memdrv_rx	1.03	同一	対応
JPEG デコーダモジュール	r_jpegd_rx	2.06	同一	未対応
JPEG エンコーダモジュール	r_jpege_rx	1.01	同一	未対応
音声録音・再生システム(独自 ADPCM コーデック) M3S-S2-Tiny モジュール	r_s2_rx	3.04	同一	未対応
オープンソース FAT ファイルシステム M3S-TFAT-Tiny モジュール	r_tfat_rx	4.02	同一	対応
M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモ ジュール	r_tfat_driver_rx	2.20	同一	対応
QE Touch Module	rm_touch_qe	2.00	更新	対応
ファームウェアアップデート モジュール	r_fwup	1.01	同一	未対応
Sensor Communication Middleware Control Module	r_comms_i2c_rx	1.00	同一	対応
HS300x Sensor Control Module	r_hs300x_rx	1.00	同一	対応

#### 4. 使用方法

RX Driver Package は、「スマート・コンフィグレータ」<sup>(注1)</sup>または、「FIT Configurator」<sup>(注2)</sup>を用いることで、アプリケーションプログラムを簡単に構築することができます。

使用方法の詳細は使用ツールにより、表 4-1 のいずれかのドキュメントを参照してください。

注 1 : e<sup>2</sup> studio、CS+、IAREW でサポートしています。

注 2 : スマート・コンフィグレータでサポートしていないデバイスのみ、e<sup>2</sup> studio でサポートしています。

表 4-1 使用方法の参照ドキュメント 一覧

使用ツール	参照ドキュメント
e <sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ	RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: e <sup>2</sup> studio 編 (R20AN0451)
CS+ スマート・コンフィグレータ	RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: CS+編 (R20AN0470)
IAREW スマート・コンフィグレータ	RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: IAREW 編 (R20AN0535)
e <sup>2</sup> studio FIT Configurator	RX ファミリ e <sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)

## 5. 補足

### 5.1 サンプルプログラムについて

RX Driver Package は FIT モジュール群をパッケージングしたものであり、動作確認用のサンプルプログラムは同梱していません。サンプルプログラムが必要な場合、FIT モジュール単体のパッケージを別途ダウンロードしてください（注 1）。FIT モジュール単体パッケージには「FITDemos」フォルダが用意されており、サンプルプログラムもしくはサンプルプロジェクトを同梱しています。

もしくは、スマート・コンフィグレータの FIT モジュール・サンプルのダウンロードとプロジェクトインポート機能を使用することで、サンプルプロジェクトを簡単に e<sup>2</sup>studio のワークスペースにインポートすることが可能です。詳細はスマート・コンフィグレータ V.2.0.0 リリースノート(R20UT4475)をご参照ください。

注 1： FIT モジュールによってはサンプルプログラムを用意していない場合があります。

### 5.2 各 FIT モジュールの API 情報の格納場所について

プロジェクトに組み込んだ FIT モジュールの API 情報は、組み込んだ各 FIT モジュールフォルダの doc フォルダ内を参照してください。

### 5.3 ダウンロードした RX Driver Package の確認方法

ダウンロードが正常に実行された場合、「4 使用方法」にある参照ドキュメントで指定したフォルダに FIT モジュールが格納されます（例：C:\Renesas\e2\_studio\FITModules）。

また、「FITModules\Downloaded」フォルダには本パッケージの ZIP ファイルが格納されます。

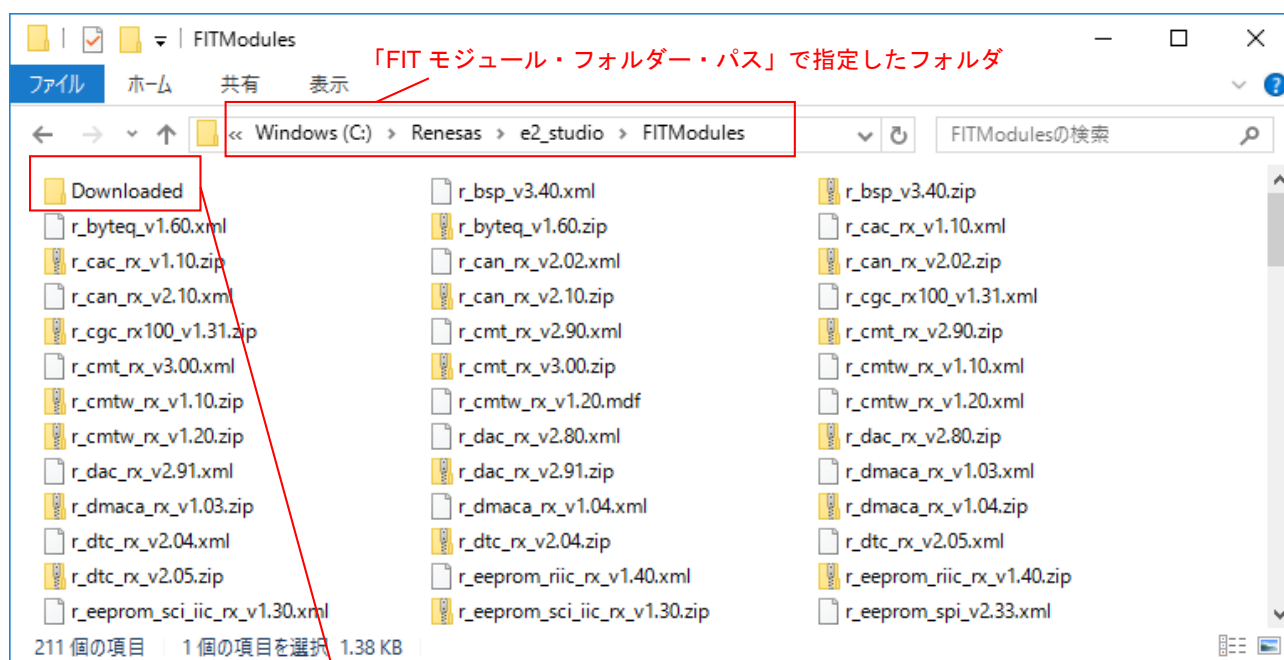


図 5-1 RX Driver Package

本パッケージの ZIP ファイルが格納されています  
(r01an\*\*\*\*xx\*\*\*\*-rx-fit.zip)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.31	2021.08.31	－	初版発行

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレイやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力ブルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力ブルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因またはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
  8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
  13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)